

SEMICON® JAPAN

2頭硬脆材料ウェーハ研削盤 Model DDT832



SiC Al₂O₃ GaN etc
4~8インチウェーハに対応



ハイパワースピンドルで
ウェーハを高効率研削!!



JTEKT ジェイテクトマシンシステム
JTEKT MACHINE SYSTEMS CORPORATION

出展のご案内

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社はこのたび「SEMICON JAPAN 2025」へ出展いたしますのでご案内申し上げます。
今回は、以下の3点をテーマとした展示を行います。

- ①2頭硬脆材料ウェーハ研削盤 DDT832→4~8インチウェーハに対応
- ②シリコンウェーハ研削盤 DXSG320→シリコンウェーハを両面同時研削
- ③新工法のご提案

この機会に是非、ご来場賜りますようにお願い申し上げます。

敬具

2025年11月吉日
株式会社ジェイテクトマシンシステム
代表取締役社長 熊谷 朋久

開催概要・出展位置

会期:2025年12月17日(水)~19日(金)

開催時間:10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト

出展位置:**東4ホール E4008**

共同出展: 株式会社ジェイテクトグラインディングツール

来場・セミナー登録は[こちら](#)



JTEKT 株式会社ジェイテクトマシンシステム